

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-079

康达新材料（集团）股份有限公司

关于签署收购意向协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2025年6月19日与成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”或“标的公司”）及其股东辽宁四和微科技有限公司（以下简称“辽宁四和微”）、赵峰、孙丽娜签署了《收购意向协议》，公司拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权，本次交易完成后公司预计将实现对标的公司的控股。

2、本次签署的《收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，旨在表达各方合作意向。本次交易尚处于初步筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，交易的具体方案尚需交易各方进行进一步的协商和论证，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

3、标的公司100%股权的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、公司将根据相关法律法规的规定履行交易进展情况持续信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次收购标的公司及意向概述

中科华微是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务。中科华微立足于核心技术，针对当前和未来市场需求，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路（SiP）四大产品管线，包括微控制器芯片 MCU

和 SOC（32 位微型控制器电路、16 位微控制器电路、8 位微控制器电路等）、系统级 SIP 芯片（射频综合控制 SIP 芯片、数据处理模块、异构处理器 SIP 芯片）、各类模拟集成电路（电源管理、接口电路、信号链电路等）以及电路模块等系列产品，尤其在特种装备 MCU 国产替代细分领域具有技术优势和市场影响力。中科华微被认定为第六批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获评四川省瞪羚企业、成都市企业技术中心，相关领域资质齐全。

中科华微以微控制器（MCU）、高功率密度电源和系统级封装电路（SiP）为核心，并拓展外围电路，形成完整的国产化解决方案，为客户提供增值与服务。中科华微在现有产品优势和市场规模的基础上，未来将进一步扩大完善产品谱系，围绕国家和客户需要，塑造数字电路和模拟电路双轮驱动的业务格局，服务特种装备领域快速发展的技术需求。

2025 年 6 月 19 日，公司与中科华微及其股东辽宁四和微、赵峰、孙丽娜签署《投资合作意向协议》，拟以现金方式收购中科华微不低于 51%的股权，实现对标的公司的控股之目的，标的公司 100%股权的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准。

本次签署的《收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，旨在表达各方合作意向。本次交易尚处于初步筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，交易的具体方案尚需交易各方进行进一步的协商和论证，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）对手方一

- 1、名称：辽宁四和微科技有限公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、法定代表人：孙丽娜
- 4、成立日期：2019 年 1 月 7 日
- 5、统一社会信用代码：91210900MA0YDFP17E
- 6、公司住所：辽宁省阜新高新技术产业开发区新都路 63-117
- 7、经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股权结构：孙丽娜和赵峰分别持有辽宁四和微 95%和 5%的股权。

（二）对手方二

赵峰，男，中国国籍，身份证号码：21090219*****

（三）对手方三

孙丽娜，女，中国国籍，身份证号码：21090519*****

截至本公告披露日，本次交易的交易对方不属于失信被执行人。经公司自查，上述交易对方未持有公司股份、与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）基本情况

1、名称：成都中科华微电子有限公司

2、注册资本：1,296 万元人民币

3、法定代表人：孙丽娜

4、成立日期：2014 年 10 月 15 日

5、统一社会信用代码：91510100394287808P

6、公司住所：成都高新区天辰路 88 号 2 栋 2 单元 3 楼 301 号

7、经营范围：半导体分立器件、集成电路、电源模块、电子元器件、电子设备、计算机软硬件、电子产品、机电产品的设计、生产、销售及相关领域的技术开发、技术咨询、技术转让并提供技术服务；计算机系统集成。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（二）股权结构

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	辽宁四和微科技有限公司	960.00	74.0741
2	海南朗山科技有限公司	216.00	16.6667
3	北京元六鸿远电子科技股份有限公司	96.00	7.4074

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
4	青岛初尧弘毅创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	24.00	1.8519
合计		1,296.00	100.0000

四、意向协议书的主要内容

1、协议签订主体：

- (1) 甲方（收购方）：康达新材料（集团）股份有限公司；
- (2) 乙方：辽宁四和微科技有限公司；
- (3) 丙方 1：赵峰，丙方 2：孙丽娜；
- (4) 丁方（标的公司）：成都中科华微电子有限公司。

2、本次收购概述：

经各方初步协商，收购方拟以现金方式收购届时股东（“出售方”）持有的中科华微不低于 51%的股权（对应标的公司人民币 660.96 万元注册资本，“标的股权”），以实现对标的公司的控股。

在满足本协议及届时正式交易文件（结合实际情况需要，包括但不限于投资协议、股权转让协议、标的公司更新后章程等，统称“正式交易文件”）约定相关条件的情形下，收购方拟实施本次收购。

3、本次收购的先决条件：

(1) 收购方及其委托的中介机构（包括律师事务所、审计机构、评估机构等）已完成对标的公司的尽职调查，并认为标的公司及标的股权不存在重大瑕疵，且届时参与本次收购的交易各方（包括收购方、出售方、标的公司及其实际控制人等，统称“交易各方”）已根据收购方尽职调查结果就相关事项和解决方法及本次收购的最终方案达成一致意见；

(2) 交易各方已经依据证券监管、信息披露等各方面的法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所、行业主管机构、国有资产管理部门等各有权部门的监管要求，获得必要的主管部门的批准文件或证明（如需）；

(3) 交易各方已根据各自适用的法律、法规、规则、章程等规定就本次收购完成内部批准程序，并取得了各自相应的授权和批准；

(4) 截至本次收购先决条件满足之日，标的公司按照正常及既往的方式管

理业务，没有对标的公司整体估值产生重大不利影响的情形发生，包括但不限于标的公司业务、财务状况以及股权结构等方面（事先已经交易各方同意的除外）；

（5）收购方根据尽职调查情况而合理提出的其他条件。

4、交易价格及定价方式：

标的公司在本次收购中的估值以及标的股权的收购对价，将结合收购方尽职调查工作结果，以收购方聘请的资产评估机构出具的《资产评估报告》所确定的评估值为依据，由交易各方协商确定，并以正式交易文件约定为准。为免疑义，本次收购以 2025 年 3 月 31 日作为评估基准日。

5、排他条款：

在本协议有效期内，乙方、丙方及丁方应保证标的公司的股权结构稳定（本协议已有约定或经收购方事先书面同意的除外），同时保证不与其他上市公司或投资方进行以出售标的公司股权（包括增资等）为事由的接触，并且不进行与本次收购存在利益冲突的事项。

6、违约责任：

（1）如乙方、丙方或丁方违反排他条款约定的，收购方有权单方放弃/终止本次收购，且乙方、丙方及丁方应向收购方支付人民币 3,000 万元的违约金，并承担收购方因本次收购发生的中介机构费用；

（2）在收购方完成尽职调查工作后认为标的公司不存在重大瑕疵，且最终确认的本次收购之具体条件较本协议之约定未有实质性变化的前提下，任何一方不得单方面拒绝达成并签署正式交易文件；否则，守约一方有权要求违约方就该违约行为承担人民币 3,000 万元的违约金，并承担守约方因本次收购发生的中介机构费用。

7、适用法律与争议解决：

（1）本协议的订立、履行、效力、解释、争议及纠纷的解决均适用中国法律。

（2）因本协议产生的争议，各方应通过友好协商解决。若在争议发生后未能通过友好协商解决，则任何一方可将该争议提交上海仲裁委员会裁决。仲裁裁决是终局的，对各方均具备约束力。

8、生效及其他：

（1）本协议自各方签署之日起生效，且有效期为生效之日起满六（6）个月

止。

(2) 本协议仅为本次收购的意向协议，届时各方/交易各方履行本次收购应以最终签订的正式交易文件为准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司在“新材料+电子科技”的战略驱动下有序布局，拟通过本次收购实现在半导体集成电路领域的拓展，纳入特种集成电路设计与检测领域的优质资产，形成新的利润增长点，提升公司盈利能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

作为国有控股企业，公司将以现有半导体材料产业（包括 CMP 抛光液、溅射靶材、陶瓷材料、电子化学品等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级。公司以突破关键领域“卡脖子”问题、填补国内空白为己任，立足“硬科技”，依托前期布局，着力构建涵盖集成电路设计、制造（含 IC、功率半导体 IGBT 芯片及器件等）及封装测试的产业链条。公司战略布局高度契合国家产业政策导向，符合公司长远发展和战略规划。

此外，本次交易不涉及发行股份购买资产，对公司的股权结构不构成影响；交易完成后，预计公司的营业收入及净利润水平将进一步提高，公司抗风险能力将得到有效增强。

六、风险提示

本次签订的意向协议书仅为双方基本意愿的意向性约定，交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，最终交易方案尚需公司、标的公司及交易对手方履行必要的内外部相关的决策审批程序，本次交易存在不能达成正式协议及协议未能通过决策审议而终止的风险，交易能否最终实施存在重大不确定性。

公司将严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《收购意向协议》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日